



(51) Classification internationale des brevets :
G06K 19/077 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2014/061473

(22) Date de dépôt international :
3 juin 2014 (03.06.2014)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
13305764.6 7 juin 2013 (07.06.2013) EP

(71) Déposant : GEMALTO SA [FR/FR]; 6, rue de la Verrière, F-92190 Meudon (FR).

(72) Inventeurs : ALLOT, Francis; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jjubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). LOMBARDO, Sophie; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jjubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). LANKINEN, Mikko; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jjubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). KAMAGATE, Youssiph; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jjubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). BLACHON, Frédéric; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jjubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

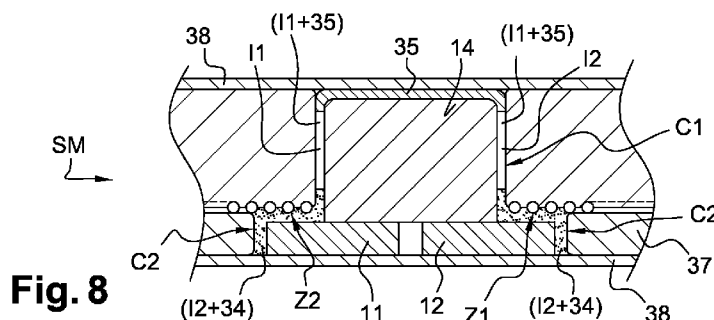
(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues (règle 48.2.h))

(54) Title : METHOD FOR MAKING AN ANTI-CRACK ELECTRONIC DEVICE

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE ANTI-FISSURATION



(57) Abstract : The invention relates to a method for making an intermediate electronic device (SM), wherein said device is coated or is to be coated with a cover sheet or layer, the method comprising the step of forming a carrier-body (31, 32) comprising: a cavity (C1, C2) provided in the carrier-body; an electric circuit (32) comprising at least one electric interconnection area (Z1, Z2) inside the cavity; an electronic module (17) comprising at least one connection pad (10, 11) connecting said interconnection area and arranged in the cavity; a space or gap (I1, I2) provided at the interface between the module and the carrier-body, substantially perpendicular to a main surface of the carrier-body, in communication with the surface of the carrier-body, and intended to be covered with a cover sheet or layer; the method is characterized in that a flexible or elastic material is arranged in the device so as to fill the space or gap between the module and the body-carrier or at least partially cover same.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]



L'invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif électronique intermédiaire (SM), ledit dispositif étant recouvert ou destiné à être recouvert d'une feuille ou couche de couverture, ledit procédé comportant une étape de formation d'un corps-support (31, 32) comportant : - une cavité (C1, C2) ménagée dans le corps-support, - un circuit électrique (32) comportant au moins une zone d'interconnexion (Z1, Z2) électrique à l'intérieur de la cavité, - un module électronique (17) comportant au moins une plage de connexion (10, 11) connectant ladite zone d'interconnexion, disposé dans la cavité - un espace ou interstice (I1, I2) existant à l'interface entre le module et le corps-support, orienté sensiblement perpendiculairement à une surface principale du corps-support, débouchant en surface du corps-support et étant destiné à être recouvert d'une feuille ou couche de couverture; Le procédé se distingue en ce qu'une matière souple ou élastique est agencée dans le dispositif de manière à remplir ou recouvrir au moins partiellement ledit espace ou interstice entre le module et le corps-support.